

H3C SR6600_SR6602X-CMW520-R3103P07版本发布公告

一、使用范围及配套说明:

表1 版本配套表-1

产品系列	SR6600系列
型号	SR6602
内存	2G/4G
FLASH/CF卡	最小256M
BootWare版本号	随主机版本自动升级，本次版本加载之后将升级为1.34。
目标文件名称及MD5校验码	SR6602-CMW520-R3103P07.bin: dda415f083f0c0182c9b849f93730a23
iMC版本号	iMC EAD 5.2 (E0402) iMC MVM 5.2 (E0401H01) iMC NTA 5.2 (E0401P02) iMC PLAT 5.2 (E0401H02) iMC QoS 5.2 (E0401) iMC TAM 5.2 (E0401) iMC UAM 5.2 (E0402) iMC UBA 5.2 (E0401P02)
iNode版本号	iNode PC 5.2 (E0402)
备注	无

表2 版本配套表-2

产品系列	SR6602-X系列
型号	SR6602-X1/SR6602-X2
内存	SR6602-X1: 2G/4G SR6602-X2: 4G
FLASH/CF卡	最小512M
BootWare版本号	随主机版本自动升级，本次版本加载之后将升级为1.15。
目标文件名称及MD5校验码	SR6602X_MCP-CMW520-R3103P07.bin: ccf85346b037d39502098b46841653bd
iMC版本号	iMC EAD 5.2 (E0402) iMC MVM 5.2 (E0401H01) iMC NTA 5.2 (E0401P02) iMC PLAT 5.2 (E0401H02) iMC QoS 5.2 (E0401) iMC TAM 5.2 (E0401) iMC UAM 5.2 (E0402) iMC UBA 5.2 (E0401P02)
iNode版本号	iNode PC 5.2 (E0402)
备注	无

表3 版本配套表-3

产品系列	SR6600系列
型号	SR6604/SR6608/SR6616
内存	RPE-X1: 1G/2G RSE-X1: 2G/4G MCP-X1: 2G/4G MCP-X2: 4G FIP-100: 1G/2G FIP-110: 2G/4G FIP-200: 2G FIP-210: 2G/4G SAP-24GBP: 2G/4G SAP-48GBP: 2G/4G SAP-48GBE: 2G/4G
FLASH/CF卡	最小256M MCP-X1/MCP-X2最小1G
BootWare版本号	随主机版本自动升级，本次版本加载之后， RPE-X1主控板将升级为1.60， RSE-X1主控板将升级为1.13， MCP-X1主控板将升级为1.15， MCP-X2主控板将升级为1.15， FIP-100将升级到1.36， FIP-200将升级到1.22， FIP-110将升级到1.11， FIP-210将升级到1.07， SAP-24GBP、SAP-48GBP和SAP-48GBE将升级到1.05。

产品系列	SR6600系列
目标文件名称及MD5校验码	SR6600-CMW520-R3103P07-RPE.bin: 86567bad9d151e9c49b11b860db600c5 SR6600-CMW520-R3103P07-RSE.bin : 911a38cf85330484833a9290f1a4b679 SR6602X_MCP-CMW520-R3103P07.bin: ccf85346b037d39502098b46841653bd
iMC版本号	iMC EAD 5.2 (E0402) iMC MVM 5.2 (E0401H01) iMC NTA 5.2 (E0401P02) iMC PLAT 5.2 (E0401H02) iMC QoS 5.2 (E0401) iMC TAM 5.2 (E0401) iMC UAM 5.2 (E0402) iMC UBA 5.2 (E0401P02)
iNode版本号	iNode PC 5.2 (E0402)
备注	无

表4 产品单板配套表

单板型号	单板名称	硬件版本	逻辑版本
SR6602	H3C SR6602 1U高度路由器主机(100-240VAC,4GE/2 HIM slot)	VER. B	主机: 300 固定4GE: 100
RPE-X1	主控单元RPE-X1(1G DDR/1AUX/1CON/1GE/1CF/2USB)	VER. B	基本段: 100 200 扩展段: 200
RSE-X1	主控单元RSE-X1(2G DDR/1AUX/1CON/1GE/1CF/2USB)	VER. B	基本段: 200 扩展段: 200
SR6602-X1	SR6602-X1 路由器主机(4GE Combo,1 FIP 插槽)	VER. A	基本段: 100 扩展段: 200
SR6602-X2	SR6602-X2 路由器主机(4GE Combo,2 10GE SFP+,1 FIP 插槽)	VER. A	基本段: 100 扩展段: 200
MCP-X1	主控处理引擎	VER. A	基本段: 100 扩展段1: 200 扩展段2: 200
MCP-X2	主控处理引擎	VER. A	基本段: 100 扩展段: 200 扩展段2: 200
FIP-10	FIP-10灵活接口平台	VER. B	100
FIP-20	FIP-20灵活接口平台	VER. A	100
FIP-100	FIP-100灵活接口平台	VER. B	单板: 200 固定2GE: 100
FIP-110	FIP-110灵活接口平台	VER. A	单板: 200 固定2GE: 100
FIP-200	FIP-200灵活接口平台	VER. B	单板: 200 固定2GE: 100
FIP-210	FIP-210灵活接口平台	VER. C	单板: 200 固定2GE: 100
SAP-24GBP	24端口千兆以太网光接口模块(SFP)	VER. A	100
SAP-48GBP	48端口千兆以太网光接口模块(SFP)	VER. A	100
SAP-48GBE	48端口千兆电以太网接口模块	VER. A	100
SPE-FWM-200	H3C SR6600 防火墙 200 业务处理引擎	VER. A	300
SPE-SSL-200	H3C SR6600 SSL VPN 200 业务处理引擎	VER. A	300
SPE-IPS-200	H3C SR6600 千兆入侵防御系统模块	VER. A	300
SPE-ACG-200	H3C SR6600 应用控制网关业务板模块	VER. A	300
HIM-8FE	8端口百兆以太网电口接口模块	VER. B	100
HIM-4GBE	4端口千兆以太网电口接口模块	VER. B	200
HIM-4GBP	4端口千兆以太网光口接口模块(SFP)	VER. A	200
HIM-8GBE	8端口千兆以太网电口接口模块	VER. B	200
HIM-8GBP	8端口千兆以太网光口接口模块(SFP)	VER. A	200
HIM-1EXP	1端口万兆以太网光接口模块(XFP)	VER. A	200
HIM-CL1P	1端口OC-3/STM-1通道化E1/T1 POS接口模块(SFP)	VER. B	底板: 100 子卡: 200

HIM-CL2P	2端口OC-3/STM-1通道化E1/T1 POS接口模块(SFP)	VER. B	底板: 100 子卡: 200
HIM-CLS1P	1端口OC-3/STM-1通道化E3/T3 POS接口模块(SFP)	VER. A	100
HIM-CLS2P	2端口OC-3/STM-1通道化E3/T3 POS接口模块(SFP)	VER. A	100
HIM-MSP2P	2端口OC-3c/STM-1c或1端口OC-12c/STM-4c POS接口模块(SFP)	VER. A	100
HIM-MSP4P	4端口OC-3c/STM-1c或2端口OC-12c/STM-4c POS接口模块(SFP)	VER. A	100
HIM-PS1P	1端口OC-48/STM-16 POS接口模块(SFP)	VER. A	100
HIM-AL1P	1端口OC-3c/STM-1c ATM接口模块(SFP)	VER. A	100
HIM-AL2P	2端口OC-3c/STM-1c ATM接口模块(SFP)	VER. A	100
HIM-RS2P	2端口OC-48c/STM-16c RPR接口卡	VER. A	100

二、版本使用限制及注意事项:

1.CMW520-E2310版本

从CMW520-E2310版本开始支持SR6616设备,此款设备完全兼容原有的板卡,但是对于FIP板的BootWare软件版本有特殊要求,下表列出了对于不同版本的配套描述及相关处理方法:

BootWare版本号	FIP-100	FIP-200
<1.19	方法1: 串口升级Bootware	方法1: 串口升级Bootware 方法2: 将线卡插在0~3槽位,升级软件版本即会自动升级Bootware
1.19	方法1: 串口升级Bootware 方法2: 将线卡插在6~9槽位,升级软件版本即会自动升级Bootware	主机软件自动升级
>1.19	主机软件自动升级	主机软件自动升级

2.CMW520-R2315P08版本

从CMW520-R2315P08版本开始,由于策略路由处理优先级变更,对于按照之前的优先级进行配置的设备,在升级到新版本后,可能需要重新调整策略路由相关配置,以实现原有功能。

子句	含义	执行优先情况
apply output-interface和apply ip-address next-hop	配置策略路由由接口和下一跳	原有实现: apply output-interface命令的优先级高于apply ip-address next-hop。当两条命令同时配置并且都有效时,系统只会执行apply output-interface命令。 R2315P08及以后版本改为: apply ip-address next-hop命令的优先级高于apply output-interface。当两条命令同时配置并且都有效时,系统只会执行apply ip-address next-hop命令。
Apply default output-interface和apply ip-address default next-hop	配置策略路由由缺省接口和下一跳	原有实现: apply default output-interface命令的优先级高于apply ip-address default next-hop。当两条命令同时配置并且都有效时,系统只会执行apply default output-interface命令。 执行缺省接口和下一跳命令的前提是,在策略路由中报文没有配置接口或者下一跳,或者配置的接口和下一跳无效,并且报文目的IP地址在路由表中没有查到相应的路由(精确路由或缺省路由),这时才会使用策略路由配置的缺省下一跳或者接口。 R2315P08及以后版本改为: apply ip-address default next-hop命令的优先级高于apply default output-interface。当两条命令同时配置并且都有效时,系统只会执行apply ip-address default next-hop命令。 执行缺省接口和下一跳命令的前提是,在策略路由中报文没有配置接口或者下一跳,或者配置的接口和下一跳无效,并且报文目的IP地址在路由表中没有查到相应的精确路由,这时才会使用策略路由配置的缺省下一跳或者接口。

3.CMW520-R2604版本

当从R2604版本降级到早期版本时，所有密码相关配置无法自动恢复，需要手工重新配置。

三、增减特性说明：

版本号	项目	描述
CMW520-R3103P07	硬件特性更新	无
	软件特性更新	支持基于逐包模式的ECMP/UCMP 负载分担 支持将端口所有描述没有截断地显示出来命令
CMW520-R3103P05	硬件特性更新	无
	软件特性更新	无
CMW520-R3103P04	硬件特性更新	无
	软件特性更新	支持配置MP排序窗口的大小
CMW520-R3103P03	硬件特性更新	无
	软件特性更新	无
CMW520-R3103P02	硬件特性更新	无
	软件特性更新	无
CMW520-R3103P01	硬件特性更新	无
	软件特性更新	无
CMW520-R3103	硬件特性更新	无
	软件特性更新	支持Password-Recovery功能
CMW520-R3101	硬件特性更新	无
	软件特性更新	无
CMW520-E2706P03	硬件特性更新	无
	软件特性更新	无
CMW520-E2706	硬件特性更新	SR6600-CMW520-E2706版本支持以下硬件： ? SR6602-X1 ? SR6602-X2 ? MCP-X1 ? MCP-X2 ? FIP-10 ? FIP-20
	软件特性更新	SR6602-X/MCP-X版本首次发布

四、相比前一版本解决问题列表：

1. 201307100372

? 问题现象：当有用户用SNMP协议访问设备时，某些情况下会导致设备异常重启。
? 问题产生条件：当有用户用SNMP协议访问设备时，设备收到某些超大的SNMP报文。

2. 201305130254

? 问题现象：某些USB手机插入设备的USB口，可导致系统异常重启。
? 问题产生条件：手机通过数据线连接设备的USB口给手机充电。

3. 201308190105

? 问题现象：设备异常重启。
? 问题产生条件：设备启用L2TP功能，收到与现有L2TP session id 相同、目的地址为本机地址且嵌套35层以上的L2TP异常报文。

4. 201308090025

? 问题现象：报文无法被正常转发，且设备无法正确回应ICMP差错报文。
? 问题产生条件：需要被加密处理的原始报文设置了不分片标记，同时封装后的报文长度大于接口MTU。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套的《H3C SR6600_SR6602 X-CMW520-R3103P07版本说明书》。